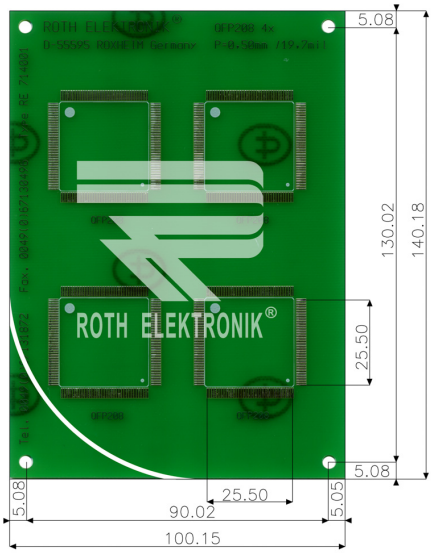

RE714001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- Placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura para SMD fine pitch QFP 208QFP 208 4 x
- Para la soldadura manual y muy adecuada para la dotación automática (Pick & Place)
- Tamaño: 100 x 140 mm

072025